

アライドマテリアルはダイヤモンド・cBN工具メーカーとして、自動車・精密機器から建築土木産業まで、幅広いお客様のグローバル化とニーズの変化に素早く対応する為、世界品質に挑戦出来る生産体制の実現を目指しております。

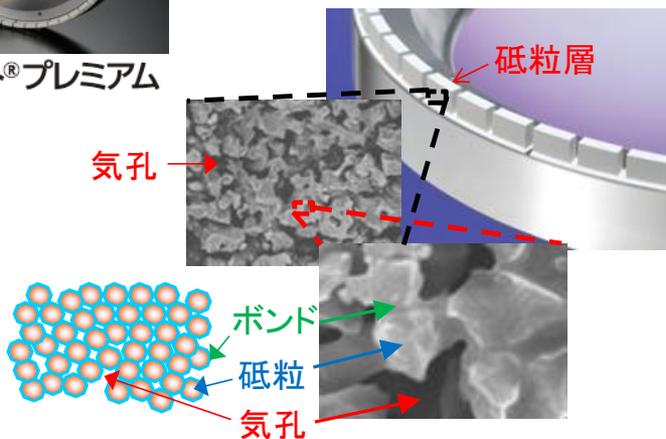
## 半導体研削用ホイールの開発



ナノメイト®プレミアム

### 特徴

- 優れた砥粒保持力
- 優れた砥粒分散性
- ドレッシング不要



高能率ダメージレス研削を実現！

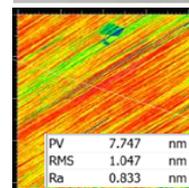
## GaN研削の実績

- ① ラップ比250倍の加工能率を実現
- ② 仕上げラップ並みの平滑化を実現

GaNウェーハ(Ga面)	2inch(現行)			4inch(次世代)		
	粗			仕上げ		
研削工程	粗			仕上げ		
粒度(粒径)	#2000(9μm)			#6000(1.5μm)		
取しろ(μm)	50-100			10		
送り速度(μm/min)	30	60	90	20	30	90
摩耗率(%)	7	15	27	100	12	20
加工面品位Ra(nm)	90	-	-	1-2	100	-



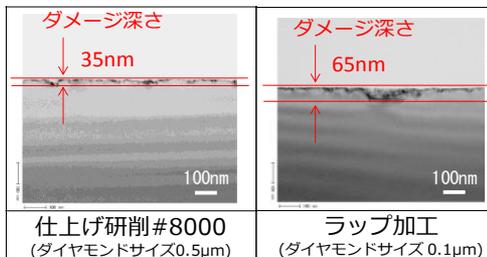
4inch GaN



仕上げ研削#6000

## SiC研削の実績

- ① ラップ比250倍の加工能率を実現
- ② 極薄化(15 μm以下)を達成
- ③ 平滑化とダメージレスを両立



仕上げ研削#8000  
(ダイヤモンドサイズ0.5μm)

ラップ加工  
(ダイヤモンドサイズ0.1μm)



SEMICON JAPAN 2016

15μm極薄 6inch SiC